

Vitronics Soltec

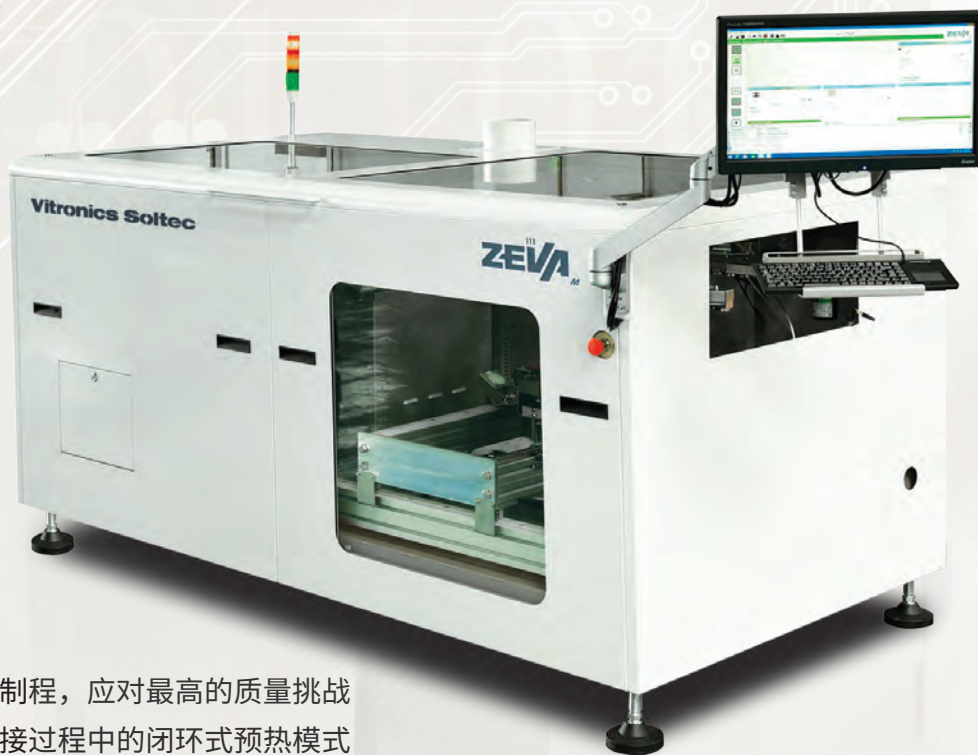
Electronic Assembly Equipment

TW EAE

ZEVA^{III}

选择性焊接解决方案

百年焊接技术
成就被经过验证的性能



- 高频助焊剂喷涂技术提供最精准的制程，应对最高的质量挑战
- 多达三组全尺寸预热单元，包含焊接过程中的闭环式预热模式
- 已获专利的倾斜焊接技术及 SDC 功能，能应对任何焊接问题，包括越来越细小的间距带来的焊接挑战
- 智能编程软件能快速设置可靠的制程方案
- 制程的控制性，可最大程度保证每天如一的性能



高频高速助焊剂滴状喷射，能满足生产周期和助焊剂液滴大小的要求



可移动式电磁锡槽有倾斜焊接的选项及可选润湿型或非润湿型焊接喷嘴



可同时焊接多达三种产品，获取最高产能



选择性焊接解决方案

ZEVA 将选择性点焊接技术提升到一个新的层面。随着组件间距尺寸越来越细小，在焊接过程中一定会需要采用倾斜焊接方式来确保令人满意的焊接效果。ZEVA 平台的 SmartTeach 智能编程软件使用户能快速设置可靠的新产品制程方案。

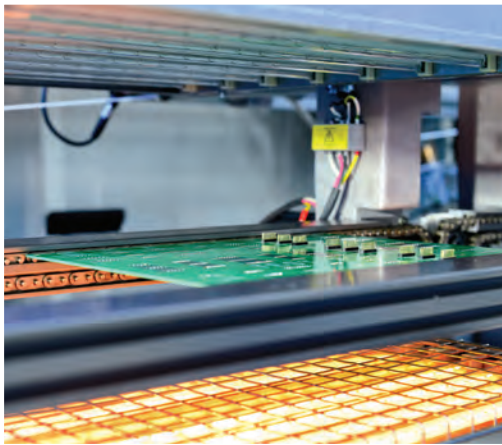
主要标配特性

- 高频助焊剂喷涂
- 在线预热
- 智能编程
- 可移动式电磁锡槽
- 自动波峰高度和焊锡高度测量

主要选项特性

- 助焊剂流量测量
- 顶部预热 (在焊接时也有顶部预热)
- 闭环式预热器管理
- 非润湿型或者润湿型焊接喷嘴
- 可倾斜焊接间距组件
- 波峰锡流调节器 (SDC)
- 能通过摄像机观察焊接过程

型号	ZEVA
最大 PCB 或托盘尺寸	410 x 410 mm
最大 PCB 承重	10 kg
锡槽容量	8 kg
耗氮量	20 L/分钟 (25 L/分钟 包含 SDC 氮气流量)
正面最大元器件高度	120 mm
电源要求	3 x 400V 50/60 Hz
设备尺寸 (L x W x H)	2370 x 1285 x 1220 mm



底部和可选顶部石英预热器



可旋转的非润湿型焊接喷嘴，
无需操作者介入/维护



易于编程的快速产品工艺设置

ITW EAE 是依工集团下 (Illinois Tool Works, Inc) 的一个分支集团。它合并了所有电子组装设备和热处理技术。集团产品包括 MPM, Camalot, Electrovert (Speedline), Vitronics Soltec 和 Despatch 的世界级产品。